

TEC SPU 15 PLUS



jednoskładnikowy, elastyczny klej

poliuretanowy, wg.

DIN 281, EN 14293, EN 13489, ISO 17178

- bezwonny i bezrozpuszczalnikowy, klasy EC 1-R^{PLUS}
- ekologiczny i nie starzejący się
- przystosowany do ogrzewania podłogowego
- na podłoża nasiąkliwe i nienasiąkliwe, praktycznie na każde stabilne i czyste podkłady bez konieczności gruntowania
- zabrudzenia po kleju bardzo łatwe do usunięcia
- do desek wielowarstwowych i parkietu warstwowego, do krótkiego parkietu na pióro-wpust

Właściwości i zakres zastosowania

Klej poliuretanowy bez zawartości silikonu zapewniający elastyczność i wysoką wytrzymałość na zerwanie. Do klejenia desek wielowarstwowych (w tym 2- i 3-warstwowych) i parkietu wielowarstwowego oraz krótkiego litego parkietu na pióro wpust o długości do 30 cm. Minimalna temperatura podłogi przy klejeniu to +15°C i maksymalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu 75%. Klejem można kleić deski wielowarstwowe do długości 2,5 m i szerokości 25 cm. Paca B15.

Przygotowanie podłoża

Podkład musi być mocny, suchy, czysty, wolny od rys, spękań, tłuszczów i olejów (materiałów ograniczających przyczepność). Przed gruntowaniem podkład należy obowiązkowo przeszlifować i odkurzyć. Stare podkłady, podkłady wyszpachlowane masami cementowymi i podkłady z resztkami klejów należy sprawdzić pod względem przyczepności i wytrzymałości. Podkład powinien mieć wytrzymałość na ścislenie większą od 25 MPa, na odrywanie większą niż 1 MPa (badanie metodą Pull-off). Przed klejeniem sprawdzić wilgotność podkładu i jego temperaturę, a także stabilność nawierzchni metodą rysikową. Maksymalna resztkowa wilgotność dopuszczalna podkładu przed klejeniem wynosi :

- jastrychy cementowe (wilgotność $\leq 2,0$ % CM),
- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilg $\leq 2,5$ % CM)

- podkłady anhydrytowe (wilgotność $\leq 0,5$ % CM)
- podłoża drewniane (wilgotność $\leq 8\%-12$ % CM)

Na ogrzewaniu podłogowym wartości te ulegają dwukrotnemu zmniejszeniu.

Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć za pomocą frezowania i śrutowania.

Powierzchniowe rysy w podkładzie należy poszerzyć, odkurzyć i zalać gruntem TEC PRIMER EPX. Rysy posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,8-1,2 mm. W przypadku dużych ubytków podłoża naprawić masą naprawczą szybkoschnącą. W przypadku podkładów zawilgoconych do 4,5 %CM, zaleca się stworzyć warstwę przeciw wilgotnościową z gruntu TEC PRIMER PU lub EPX. Grunt należy nałożyć dwukrotnie „metodą na krzyż”. Wierzchnią warstwę gruntu posypać suchym piaskiem kwarcowym – min. 2,5 kg piasku na 1 m² powierzchni o uziarnieniu 0,6- 1,2 mm. Po związaniu gruntu, resztki piasku należy zebrać odkurzaczem. Związany w gruncie piasek kwarcowy zwiększa przyczepność masy samopoziomującej do podkładu. Na grunt wylać min. 3 mm grubości masy samopoziomującej pod parkiet. Do tak przygotowanego podkładu można kleić parkiet. Parkiet można kleić bezpośrednio do gruntu TEC PRIMER PU lub EPX. Należy pamiętać o rozpoczęciu klejenia w odpowiednim czasie po zagruntowaniu, ale nie później niż do 48 h. Przy stosowaniu gruntu TEC PRIMER D klejenie jest możliwe najwcześniej po całkowitym wyschnięciu (brak

zacieków, kałuż). Klej ten może być wykładany na prawidłowe, odpowiednie przygotowane dowolne podkłady bez konieczności gruntowania. Podkłady asfaltowe zawsze gruntujemy gruntem TEC PRIMER EPX.

Klejenie

Klej znajduje się w plastikowym opakowaniu. Kleju nie należy mieszać! Klej rozkładać równomiernie za pomocą odpowiedniej pacy. Na przygotowane podłoże nanosimy taką ilość kleju, aby wystarczyła do przyklejenia parkietu w czasie ok. 35 minut. Parkiet należy równomiernie ułożyć, docisnąć i dobrze zamocować. Pacą B7/B9/B11 kleimy parkiet wielowarstwowy, pacą B 15 kleimy deskę wielowarstwową. Prace związane z klejeniem należy wykonywać w okularach i gumowych rękawicach. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady u lekarza. Czas schnięcia otwartego zależy od wilgotności drewna, temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz od własności podkładu. Ze wzrostem temperatury i spadkiem wilgotności względnej powietrza ulega on skróceniu, przy niższej temperaturze i wyższej wilgotności względnej powietrza wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Metalowe narzędzia czyścić mechanicznie. Usuwanie świeżych plam kleju oraz czyszczenie narzędzi przeprowadzać za pomocą alkoholu etylowego.

Dane techniczne

Skład: żywice poliuretanowe

Kolor: beżowy

Konsystencja: półpłynna

Gęstość: 1,65 kg/litr

Temperatura stosowania: od +15°C do +25°C

Zużycie paca B 7 0,8-1,0 kg/m²

Zużycie paca B 9 0,9 – 1,1 kg/m²

Zużycie paca B 11 1,05 – 1,2 kg/m²

Zużycie paca B 15: 1,2-1,4 kg/m²

Czas klejenia: do 35 minut

Możliwość szlifowania: po 48 godzinach

Czas obciążania : 48 godziny

Czas wstępnego odparowania: brak

GISCODE RS 10

EMICODE EC1-R^{PLUS}

Składowanie: temp. powyżej +5C

Magazynowanie: 6 miesięcy

Opakowanie 17 kg (33 szt.-paleta)

Bezpieczeństwo i ochrona

Podczas pracy używać gumowy rękawic. Po zakończeniu prac przewietrzyć pomieszczenie. Resztek kleju w opakowaniu nie wyrzucać tylko odpowiednio i bezpiecznie utylizować. Opakowanie chronimy przed dziećmi.

Ważne wskazówki

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Niższe temperatury wydłużają czasy zastosowań, a wyższe skracają. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Bautec Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją techniczną i kartą charakterystyki produktu. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Aktualizacja 12.01.2017